# SOLID STATE IMAGE SENSING ELEMENT HAVING INFRARED CUTTING FILTER

Patent number:

JP9275198

**Publication date:** 

1997-10-21

Inventor:

KITAMURA TOMOHITO; MASUTOMI

OSAMU; UCHIDA MASANOBU

Applicant:

TOPPAN PRINTING CO LTD

Classification:

- international:

C23F4/00; G02B5/28; H01L27/14; H04N9/07; C23F4/00; G02B5/28;

H01L27/14; H04N9/07; (IPC1-7): C23F4/00;

H01L27/14; G02B5/28; H04N9/07

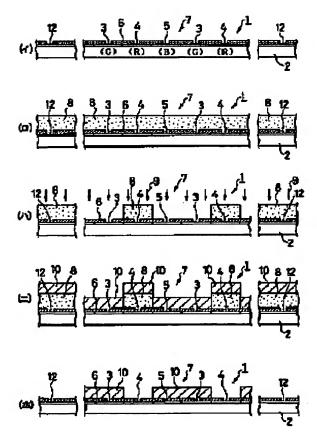
- european:

Application number: JP19960082876 19960404 Priority number(s): JP19960082876 19960404

Report a data error here

## Abstract of JP9275198

PROBLEM TO BE SOLVED: To integrally form with a sensor part an infrared shielding body which is combined with the sensor part of a solid state sensing element, by forming an infrared cutting filter by means of vapor depositor process, only on the sensitive parts to specific colors in a sensor part. SOLUTION: In a solid state image sensing element 1, green-sensitive parts 3, red-sensitive parts 4 and bluesensitive parts 5 are formed in a specified arrangement on a substrate 2, and a sensor part 7 is formed by installing a specified patterned mask 2. Heat resistant resist 8 is formed to the solid state image sensing element 1, and baking process is performed. Resist patterning for eliminating the heat resistant resist in the parts corresponding to the green-sensitive parts 3 and the blue-sensitive parts 5 is performed. To the sensor part 7 wherein the residual part is covered with the heat resistant resist 8, an infrared cutting filter 10 wherein layers are laminated by a low temperature



PAGE LEFT BLANK

2.

ion assist method is formed. As a result, a solid state image sensing element 1 wherein infrared cutting films 10 are formed in the greensensitive parts 3 and the blue-sensitive parts 5 of the sensor part 7 can be obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

PAGE LEFT BLANK

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平9-275198

(43)公開日 平成9年(1997)10月21日

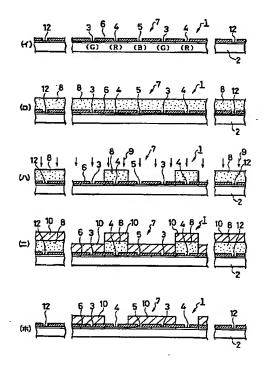
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内 <b>整理番号</b>	FΙ			技術	表示箇所
H01L 27/14			H01L 27/	/14	I	)	
G 0 2 B 5/28			G 0 2 B 5/3	/28			
H04N 9/07			H04N 9/	/07	(		•
// C 2 3 F 4/00			C23F 4/	/00	0 A		
			H01L 27/14 K				
			審查請求	未請求	請求項の数3	OL (	全 6 頁)
(21)出顧番号 .	特願平8-82876		(71)出顧人 0	000003193			
				凸版印刷	版印刷株式会社		
(22)出顧日	平成8年(1996) 4月4日	<b>月4日</b>	J	東京都台	東区台東1丁目	15番1号	
			(72)発明者 は	北村 智	史		
			3	東京都台	東区台東1丁目	5番1号	凸版印
			R	刷株式会	社内		
			(72)発明者 坩	増富 理			
			J	東京都台	東区台東1丁目	15番1号	凸版印
			R	刷株式会	社内		
			(72)発明者 内	内田 雅	信		
			J.	東京都台	東区台東1丁目	15番1号	凸版印
			A	刷株式会	社内		
			(74)代理人 乡	弁理士	秋元 輝雄		

# (54) 【発明の名称】 赤外カットフィルタ付固体撮像素子及びその製造方法

## (57)【要約】

【課題】固体撮像素子のセンサ部に赤外カットフィルタを一体化させ、紙幣や有価証券などの不正コピーの防止をより一層確実なものにする。

【解決手段】蒸着した複数の赤外カット層を順次積層してなる赤外カットフィルタ10を設け、基板上における所定の配列で前記センサ部を形成している緑色感応部と赤色感応部と青色感応部のうち、特定色の感応部以外の感応部に対応した前記赤外カットフィルタ10を除去する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】基板に緑色感応部と赤色感応部と青色感応 部とからなるセンサ部を有した固体撮像素子において、 前記センサ部における特定色の感応部上のみに、蒸着に よる赤外カットフィルタが形成されていることを特徴と する赤外カットフィルタ付固体撮像素子。

【請求項2】固体撮像素子のセンサ部に赤外カットフィ ルタを設けるに当たり、

センサ部上方側から蒸着した複数の赤外カット層を順次 積層してなる赤外カットフィルタを設け、基板上におけ る所定の配列で前記センサ部を形成している緑色感応部 と赤色感応部と青色感応部のうち、特定色の感応部以外 の感応部に対応した前記赤外カットフィルタを除去し て、前記特定色の感応部に対応する赤外カットフィルタ を残存させたことを特徴とする赤外カットフィルタ付固 体撮像素子の製造方法。

【請求項3】上記赤外カットフィルタの形成は、130 ℃以下の低温イオンアシスト蒸着によって行われる請求 項2に記載の赤外カットフィルタ付固体撮像素子の製造 方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は赤外カットフィルタ 付固体撮像素子及びその製造方法に関するものである。 [0002]

【発明が解決しようとする課題】近年、カラーコピー機 を用いた紙幣や有価証券などの偽造が問題となっている ととから、カラーコピー機の色読取りに使用される固体 撮像素子のセンサ部に赤外線を感知する固体撮像素子を 組み合わせるとともに、紙幣や有価証券などに特殊イン クを印刷にて特定パターンで施し、その特殊インクを用 いたものを前記カラーコピー機にかけて複写しようとし た場合に赤外感知の固体撮像素子を通して感知された像 の比較をカラーコピー機側で行わせ、特定の像が認知さ れたときに複写を行わないようにする工夫が提案されて いる。なお、色読取りに使用されるセンサは可視領域の みを感知するように赤外カットフィルタを固体撮像素子 に貼り合わせるようにしていた。

【0003】しかしながら、上述したように赤外カット ガラスなどを固体撮像素子に貼り付けたものにあって は、その赤外カットガラスを容易に剥がすことができる 可能性があり問題となっているとともに、赤外カットガ ラスを貼り付けることで固体撮像素子を含む撮像機器の 構造が複雑になり、製造コストを引き上げるという問題 があった。そとで本発明は上記事情に鑑み、固体撮像素 子のセンサ部に組み合わせる赤外カットの透光体をその センサ部に一体化させることを課題とし、更に赤外カッ トフィルタの一部を除去することで固体撮像素子の一部 を赤外感知センサとして使用し、紙幣や有価証券などの

的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を考慮 してなされたもので、基板に緑色感応部と赤色感応部と 青色感応部とからなるセンサ部を有した固体撮像素子に おいて、前記センサ部における特定色の感応部上のみ に、蒸着による赤外カットフィルタが形成されているこ とを特徴とする赤外カットフィルタ付固体撮像素子を提 供して、上記課題を解消するものである。また、もう一 つの発明は、固体撮像素子のセンサ部に赤外カットフィ ルタを設けるに当たり、センサ部上方側から蒸着した複 数の赤外カット層を順次積層してなる赤外カットフィル タを設け、基板上における所定の配列で前記センサ部を 形成している緑色感応部と赤色感応部と青色感応部のう ち、特定色の感応部以外の感応部に対応した前記赤外カ ットフィルタを除去して、前記特定色の感応部に対応す る赤外カットフィルタを残存させたことを特徴とする製 造方法であり、この赤外カットフィルタ付固体撮像素子 の製造方法を提供して、上記課題を解決するものであ 20 る。

【0005】本発明では、固体撮像素子のセンサ部にお ける特定色の感応部に対して赤外カットフィルタが積層 形成されて一体化された状態となっており、その赤外カ ットフィルタを剥ぎ取ることができないようになる。 [0006]

【発明の実施の形態】つぎに本発明を図1から図3に示 す実施例に基づいて詳細に説明する。図1の(イ)から (ホ)は固体撮像素子1に対して赤外カットフィルタを 設ける順序が示されている。図1の(イ)に示すよう 30 に、固体撮像素子1においては基板2に所定の配列で緑 色感応部3、赤色感応部4、青色感応部5を設け、そし て所定のパターンとしたマスク6を設けることによって センサ部7が形成されている。この固体撮像素子1に対 して(ロ)に示すように耐熱性レジスト8を厚さ約4. 5μmにして設け、この耐熱性レジスト8に対して90 ℃、30秒の条件でベーク処理を行う。つぎに前記緑色 感応部3と青色感応部5以外の部分に対応する耐熱性レ ジスト8を残しその緑色感応部3と青色感応部5に対応 する部分の耐熱性レジストを除去するレジストパターニ 40 ングを行う(図1ハ)。このバターニングは通常のマス クを用いた露光、現像の手法によるものであって、現像 のための処理液としては例えばNaCO。+NaOH+ H. Oの構成の溶液が使用され、処理時間を35秒とし て設定している。現像が終了した後には洗浄し、乾燥を 行う。その後、ポストベーク処理を行う(130℃、1 分)。このように固体撮像素子1のセンサ部7に赤外カ ットフィルタを設けるにあたっては、まず、赤外カット フィルタを形成しようとする感応部以外、即ち、図示の 実施例にあっては緑色感応部3と青色感応部5以外に対 不正コピーの防止をより一層確実なものにすることを目 50 応したパターンでレジストを設けるようにする。この

時、後述の赤外カットフィルタとの付着を高めるため に、アッシング(プラズマ処理) 9を行ってもよい。 【0007】緑色感応部3と青色感応部5以外を耐熱性 レジスト8で覆ったセンサ部7に対して(二)に示すよ うに低温イオンアシスト法により多層に積層してなる後 述の赤外カットフィルタ10が厚さ2.8~3.3μm の範囲で形成される。この後、所定のリムーバ剤 (SH IPLEY (シプレイ) 社製 商品名リムーバ116 5)を110℃、40分の条件の下で加え、上記耐熱性 レジスト8を取り除くようにじ、このレジスト8の取り 除きでその上に積層されていた赤外カットフィルタ10 が共に取り除かれるようになり(リフトオフ法)、リフ トオフ後に水洗い、乾燥を行う。このようにしてセンサ 部7の緑色感応部3と青色感応部5に赤外カットフィル タ10を設けた固体撮像素子1が得られる(ホ)。そし て、この後、既成の手法を用いて各感応部に色相バター ンを対応させるカラーフィルタが上方側から形成され る。

【0008】赤外カットフィルタの下層として酸化ケイ素(SiOz)を設けるようにしてもよく、その酸化ケイ素を設ける手順を図2に示した。なお、この二酸化ケイ素は固体撮像素子のパッドには設けない。まず、図2(イ)に示すように、全面的に二酸化ケイ素の膜11を設け、(ロ)に示すように固体撮像素子のパッド部12に対応する部分が除かれるパターンでレジスト13をパターニングする。そして、(ハ)に示すように、ドライエッチング14により、パッド部12に対応する部分の二酸化ケイ素の膜11を除去し、レジスト13を除いた後、(ニ)に示すようにアッシング9を行い、パッド部12以外を二酸化ケイ素の膜11で覆った固体撮像素子301を得て、この後、図1に示した手法にて赤外カットフィルタを設けるようにすることになる。

【0009】上記の例にあっては層として形成された赤 外カットフィルタをレジストの取り除きとともに必要部 分(上記例では緑色感応部と青色感応部に対応する部 分)以外を取り除くようにした(リフトオフ手法)もの であるが、層として形成された赤外カットフィルタに対 してドライエッチングして必要部分以外を取り除くよう にしてもよい。図3と図4にそのドライエッチングを用 いた場合の手順が示されている。図3(イ)に示すよう に、固体撮像素子1に全面的にオーバーコート15を厚 さ約3. 0μmで設け、(ロ) に示すように、その上に 多層の赤外カットフィルタ10を厚さ2.8  $\sim$   $3.3 \mu$ mの範囲で設ける。つぎに前記赤外カットフィルタ10 の上にレジスト16を設けて、赤色感応部4に対応する 部分とパッド部12に対応する部分からレジスト16が 除かれるようにパターニングする (ハ)。 なお、 レジス トは厚さ約4. 5μmとする。レジスト16のパターニ ング後、ドライエッチング14を行って、赤色感応部4

ットフィルタ10が除去されるようにする (二)。 【0010】つぎに図4(イ)に示すように、上記レジ スト16を除去した後に、アッシング9を行い。(ロ) に示すように厚さ約1. 0 μmでオーバーコート15を 設ける。そして、前記のオーバーコート15が設けられ た後に、上記パッド部12にあるオーバーコートを取り 除くようにして、特定色の感応部に対応した状態で赤外 カットフィルタを一体化させた固体撮像素子1が得られ る(ハ)。そして、この後、既成の手法を用いて各感応 部に色相パターンを対応させるカラーフィルタが上方側 から形成される。なお、上記実施例では赤外カットフィ ルタが緑色感応部と青色感応部に設けられる例を示して いるが、本発明はこれに限定されるものではない。ま た、上述した例にあっては、赤色カットフィルタを設け た後に各感応部に色相パターンを対応させてカラーフィ ルタが形成されるものとして説明したが、予め各感応部 に色相パターンを対応させた状態でカラーフィルタを設 けておき、その上方側から上記の方法で赤外カットフィ ルタを設けるようにしてもよい。

【0011】上記赤外カットフィルタ10は複数の赤外カット層17を積層してなるものであり、図5に示すように、近赤外カットフィルタ部18と長波長カットフィルタ部19とからなるものである。そしてその赤外カットフィルタ10の層構成は、

【0012】赤外カットフィルタの上記層構成において各赤外カット層の材料の一例を示されているが、この赤外カット層の材料にはつぎのものがある。高屈折材料として例えば、TiO、、CeO、、ZnSなどがあり、低屈折率材料として例えば、SiO、、MgF、などがあり、中間屈折率材料として例えばAl、O、、MgOなどがある。赤外カットフィルタにおける層数は、近赤外カットフィルタ部で11層以上であり、計21層以上が望ましい。また、赤外カット層を構成する材料の選択、組み合わせによっては層数が変わるものである(10~40層)。なお、この赤外カットフィルタは近赤外カットフィルタ部のみであってもよいものである。

 5

一例を以下に示す。

開始真空圧:10<sup>-1</sup>~10<sup>-1</sup>paζ、

チャンパー内温度:130℃以下

 $TiO_2$  において、レートを1.5A/s、酸素をバックフィルガスとし、ガス圧は $10^{-2}$  pa  $\xi$ の雰囲気中で500e V おエネルギーにてイオンアシストを行う。 $SiO_2$  において、レートを2.0A/s、300e Vのエネルギーでイオンアシストを行う。この時、チャンバー内にバックフィルガスは導入しない。イオンクリーニングは、300e Vのエネルギーで30se c程とする。アシストガス(イオン銃(カフマン型イオン銃)に導入されるガス)は、 $Ar+10\%O_2$ 、7SCCMである。

#### [0014]

【発明の効果】以上説明したように本発明の赤外カット フィルタ付固体撮像素子によれば、基板に緑色感応部と 赤色感応部と青色感応部とからなるセンサ部を有した固 体撮像素子であって、前記センサ部における特定色の感 応部上のみに、蒸着による赤外カットフィルタが形成さ れていることを特徴とするものである。このように赤外 カットフィルタが一体に形成されているため、その赤外 カットフィルタの剥離が非常に困難なものとなり、言い 換えれば赤外カットフィルタの取り外しを防止できると いう効果がある。またもう一つの発明によれば、固体撮 像素子のセンサ部に赤外カットフィルタを設けるに当た り、センサ部上方側から蒸着した複数の赤外カット層を 順次積層してなる赤外カットフィルタを設け、基板上に おける所定の配列で前記センサ部を形成している緑色感 応部と赤色感応部と青色感応部のうち、特定色の感応部 以外の感応部に対応した前記赤外カットフィルタを除去 30 して、前記特定色の感応部に対応する赤外カットフィル タを残存させたことを特徴とするものである。このよう に固体撮像素子の特定部分に、蒸着にて積層してなる赤 外カットフィルタが設けられるので、従来の赤外カット ガラスを貼り合わせた構造のものに比べて撮像機器部分 の構造が簡単であり、また、センサ部に赤外カットフィ ルタが一体化するためにその赤外カットフィルタを剥ぎ 取ることができなくなり、よって、カラーコピー機の特 定赤外パターンを認識して不正コピーを防止するシステ ムが極めて有効なものにすることができるようになる。

そして、センサ部における赤外カットフィルタを設けない感応部を赤外フィルタとして活用できるようになる。さらに、赤外カットフィルタの形成を130℃以下の低温イオンアシスト蒸着により行うようにすることで、基板上への赤外カットフィルタの形成が容易であり、剥離が困難である赤外カットフィルタが得られるなど、実用性に優れた効果を奏するものである。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る赤外カットフィルタ付固体撮像素 7のリフトオフによる製造方法を示すもので、(イ)は耐熱性レジストを設ける前の状態を示す説明図、(ロ)は耐熱性レジストを設けた状態を示す説明図、(ハ)は耐熱性レジストをパターニングした状態を示す説明図、(ニ)は赤外カットフィルタを設けた状態を示す説明図である。【図2】予め固体撮像素子側に二酸化ケイ素の膜を設ける手順を示すもので、(イ)は二酸化ケイ素の膜を全面的に設けた状態を示す説明図、(ロ)はレジストをパターニンクした状態を示す説明図、(ロ)はドライエッチング状態を示す説明図、(ニ)はアッシングの状態を示す説明図である。

【図3】赤外カットフィルタ付固体撮像素子のドライエッチングによる製造方法を示すもので、(イ)はオーバーコートした状態を示す説明図、(ロ)は赤外カットフィルタを設けた状態を示す説明図、(ハ)はレジストをパターニングした状態を示す説明図、(ニ)は赤外カットフィルタをドライエッチングした状態を示す説明図である。

【図4】同じく赤外カットフィルタ付固体撮像素子のドライエッチングによる製造方法を示すもので、(イ)はアッシングした状態を示す説明図、(ロ)はオーバーコートを設けた状態を示す説明図、(ハ)は所要のオーバーコートを除去した状態を示す説明図である。

【図5】赤外カットフィルタの層構成を示す説明図である。

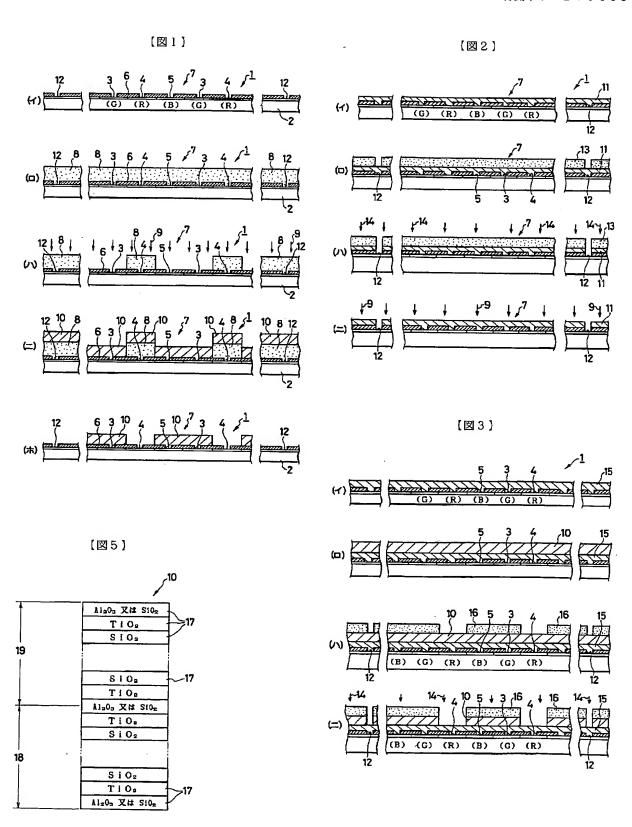
【符号の説明】

1…固体撮像素子

2…基板

7…センサ部

○ 10…赤外カットフィルタ



【図4】

